

TEAM-100 全自動ウェーハ表面保護テープ貼付装置

FAutomatic Wafer Protective Tape Lamination System

【概要 - Outline -】

- ◆本装置はウェーハの裏面研磨及び、その他プロセス工程として必要なテープのラミネートをウェーハ内周に全自動で行う装置です。
The ideal system for laminating tape within the circumference of the wafer prior to the backgrind process.

【特長 - Features -】

- ◆真空状態でテープとウェーハを貼付けることにより、気泡の発生が無くウェーハにダメージを与えません。
Vacuum chamber application eliminates air bubbles and preserves integrity of wafers.
- ◆従来の B/G テープが使用でき、特殊テープ（ワッペン釘ヌキ）は不要です。
Normal B/G tape roll applicable. Pre-cut tape is not necessary.
- ◆ウェーハは内周に設定したテープサイズにカット可能です。
Ability to determine the diameter of the cut and laminate within the circumference of the wafer.
- ◆テープはノンテンション方式にてストレス無く貼付けられます。
Reduced tension on the lamination tape.



仕様 Specification	TEAM - 100	
スループット Throughput	50 枚 /h (ご使用条件により異なります Depend on data setting)	
対応ウェーハサイズ Wafer Size	5・6・8 inch	
使用テープ幅 Tape Width	5 inch : W 150 mm / 6 inch : W 180 mm / 8 inch : W 230 mm	
ユーティリティ Utilities	電源 Power	AC100V 単相 Single phase 50/60Hz 2.0KVA
	空気源 air	圧力 Pressure 0.5Mpa 100N/min
	真空源 Vacuum source	-74Kpa
装置寸法 Demension	W 1,400 × D 1,000 × H 1,650 mm	
重量 Weight	600 kg	

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.